



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 108542044 B

(45) 授权公告日 2024. 04. 02

(21) 申请号 201810561205.5

(22) 申请日 2018.06.04

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108542044 A

(43) 申请公布日 2018.09.18

(73) 专利权人 深圳市中荣威科技有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区平湖街
道平安大道171号飞鹏工业区29栋3楼

(72) 发明人 马庆峰

(74) 专利代理机构 深圳紫晴专利代理事务所
(普通合伙) 44646
专利代理师 雒盛林

(51) Int. Cl.
A43B 23/00 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 103720136 A, 2014.04.16

CN 103783726 A, 2014.05.14

CN 105708048 A, 2016.06.29

CN 206534197 U, 2017.10.03

CN 207084289 U, 2018.03.13

CN 208274226 U, 2018.12.25

JP 5775205 B1, 2015.09.09

WO 2017173865 A1, 2017.10.12

史妍. 高跟鞋不再磨脚的小秘方. 健康向导
.2011, (第05期), 16-19.

审查员 林建锋

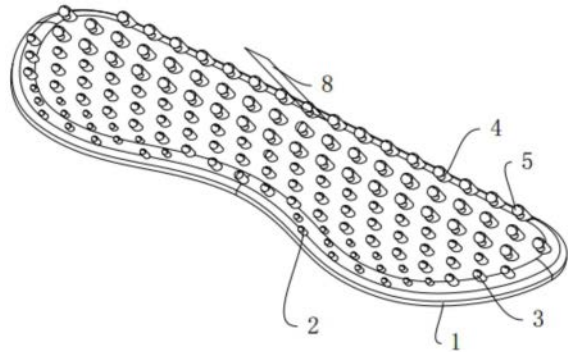
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 发明名称

一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴

(57) 摘要

本发明公开了一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,包括后跟贴本体,所述后跟贴本体的上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面,所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵,针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度,针刺阵包括低针刺阵、中针刺阵和高针刺阵,所述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置。本发明属于后跟贴技术领域,具体是提供了一种实用性高、使用便捷、适配度高、舒适性强、真正实现适配于各种鞋型和各种脚型、全面解决鞋体磨脚和不跟脚等问题的后跟贴。



1. 一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,包括后跟贴本体,其特征在于:所述后跟贴本体的上下表面分别设有卡位面 and 黏胶固定面,所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵,针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度,针刺阵包括低针刺阵、中针刺阵和高针刺阵,所述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置;

所述针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置,所述针刺阵与后跟贴本体的倾斜角度为 $0-90^{\circ}$;

所述后跟贴本体的厚度为 $1-6\text{mm}$,所述低针刺阵中针刺的长度为 1.5mm ,所述高针刺阵中针刺的长度为 3.5mm ;

所述针刺阵中的针刺呈圆柱体设置,针刺中上部设有切面,针刺的末端设有吸盘;

所述后跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置;

所述高针刺阵中的针刺上侧壁设有凹槽;

所述卡位面上设有斜撑。

2. 根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,其特征在于:所述黏胶固定面为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。

3. 根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,其特征在于:所述黏胶固定面上设有离型纸层。

4. 根据权利要求1所述的一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,其特征在于:所述后跟贴本体为柔软材质制成,柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料。

一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴

技术领域

[0001] 本发明属于后跟贴技术领域,具体是指一种防止磨脚跟和掉跟的后跟贴。

背景技术

[0002] 现代社会,人们对生活品质的追求越来越高,对穿着脚部的鞋体的舒适度也有了更高要求。由于鞋体都是大批量按照同样尺寸规格,相同工艺制成,而人的脚形却千差万别各不相同,因此买的鞋体也难免保证符合所有人的脚型。特别是女士在穿高跟鞋时,高跟鞋的后跟处经常会留下空隙,造成脚经常会脱离高跟鞋,鞋体容易掉落。即使没有掉落,也会造成脚后跟与鞋体之间不断摩擦,上述会对脚后跟造成损伤,并且影响脚部穿着鞋体的舒适度。在后跟处垫上布条或卫生纸等方式虽可起到一定作用,但布条和卫生纸没有固定,在走动的过程中反复摩擦容易脱出,上述方法仅可作为临时应急之用。

[0003] 目前现有技术也有关于后跟贴的相关报道,后跟贴是一种底部具有特制的软胶,并可牢固地粘在鞋底上,既能保持良好地形状,又不会损伤鞋体的一种后跟贴。目前的后跟贴,结构一般是包括底层、设置在底层上的棉层、位于棉层上的粘胶层,以及覆盖在粘胶层上的离型纸,此种结构的后跟贴使用时,剥离离型纸,将粘胶层的一面与鞋体后脚跟位置相贴即可。但是上述后跟贴结构及市面通用后跟贴,接触脚皮肤面是平面或者按摩面,没有设计卡位面,平面或按摩面只是通过本体的厚度粘在鞋跟处,起到缩小鞋体内部尺码的作用,并未涉及如何较好的利用后跟贴接触面达到固定脚后跟的目的和效果。另外,后跟贴普遍存在功能性单一,仅适合高跟鞋使用,或者仅适合脚瘦的使用,使用过程中,适配度不加,舒适性不强,使用后同样存在小程度上的磨脚、鞋子不跟脚等问题。

发明内容

[0004] 为解决上述现有难题,本发明提供了一种实用性高、使用便捷、适配度高、舒适性强、真正实现适配于各种鞋型和各种脚型、全面解决鞋体磨脚和不跟脚等问题的后跟贴。

[0005] 本发明采取的技术方案如下:本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,包括后跟贴本体,所述后跟贴本体的上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面,所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵,针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度,针刺阵包括低针刺阵、中针刺阵和高针刺阵,所述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置。

[0006] 本方案呈阶梯式升序排列的针刺阵使得本发明后跟贴的卡位面与人脚后跟的曲面完美贴合,目的在于脚后跟部和鞋体即将脱落时将鞋体卡住,有效防止不掉跟。

[0007] 卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵,后跟贴自下而上分低针刺阵、中针刺阵和高针刺阵,最下层的低针刺阵中针刺高度较矮,最高层的高针刺阵中针刺最高,形成坡度,上述设计原理是脚跟贴和鞋子接触的紧密程度与高针刺阵触疏远有关,这样与脚形成互补,达到防掉跟防不跟脚效果。

[0008] 进一步地,所述针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置,所述针刺阵与后跟贴本体的倾斜角度为0-90°。针刺阵及其针刺的角度是本方案设计的重点,针刺阵中针刺向下倾斜0-

90°之间,上述范围有两大作用,一是穿鞋的时候可直接顺势将针刺部分压下去,当脱鞋时,针刺阵中的针刺对鞋面施以反作用力,使得本发明后跟贴穿脱方便;二是穿着时针刺与鞋面摩擦力大,当掉跟现象可能发生时,针刺受到脱鞋力,并结合材料本身材质的韧性形成反作用力,这样真正有效避免了掉跟与不跟脚现象的发生。

[0009] 作为优选地,所述后跟贴本体的厚度为1-6mm。

[0010] 作为优选地,所述低针刺阵中针刺的长度为1.5mm,所述高针刺阵中针刺的长度为3.5mm。

[0011] 进一步地,所述针刺阵中的针刺呈圆柱体设置,针刺中上部设有切面,针刺的末端设有吸盘。针刺阵中的针刺结构部分,针刺正常是圆柱体,将圆柱体中上部位做切面处理,切面接触脚皮肤面积更大,吸附效果更好,圆柱体末端设计小吸盘结构,目的也是扩大接触面积,使用时不掉跟不磨脚。

[0012] 作为优选地,所述后跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置,弧度适配于人常规通用脚型,与人体脚后跟构型相适配。

[0013] 进一步地,所述高针刺阵中的针刺上侧壁设有凹槽。目的在于脚后跟部和鞋体即将脱落时将鞋体卡住,有效防止不掉跟。

[0014] 进一步地,所述卡位面上设有斜撑。优选地,斜撑设于高针刺阵的中部位置,斜撑优选为柔软材质制成,斜撑呈斜向下的角度设置,斜撑的作用也是进一步的实现在脚后跟部和鞋体即将脱落时将鞋体卡住,有效防止不掉跟。

[0015] 进一步地,所述黏胶固定面为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。

[0016] 进一步地,所述黏胶固定面上设有离型纸层。

[0017] 作为优选地,所述后跟贴本体为柔软材质制成,柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料,有效避免磨脚。

[0018] 采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本方案防止磨脚跟和掉跟的后跟贴结构设计合理,使用便捷,适配度高,舒适性强,能够真正意义上实现适配于各种鞋型和各种脚型,鞋型包括春夏秋冬的各款鞋体,例如但不限于皮鞋、高跟鞋、运动鞋、休闲鞋,各种脚型主要包括胖形脚和瘦形脚,本发明能够全面解决鞋体磨脚和不跟脚等问题。经试用,客户满意度高,具备广泛的市场推广价值。

附图说明

[0019] 图1为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴结构示意图;

[0020] 图2为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴无斜撑状态的结构示意图;

[0021] 图3为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴的高针刺阵中针刺结构示意图;

[0022] 图4为本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴反面结构示意图。

[0023] 其中,1、黏胶固定面,2、低针刺阵,3、中针刺阵,4、高针刺阵,5、切面,6、吸盘,7、凹槽,8、斜撑。

具体实施方式

[0024] 下面结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明,本发明所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均为采用的现有技术。以下结合附图,对本发明

做进一步详细说明。

[0025] 如图1和2所示,本发明防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,包括后跟贴本体,所述后跟贴本体的上下表面分别设有卡位面和黏胶固定面1,所述卡位面包括呈阶梯式升序排列的针刺阵,针刺阵与后跟贴本体呈倾斜角度,针刺阵包括低针刺阵2、中针刺阵3和高针刺阵4,所述后跟贴本体的下端部构型与人体脚后跟构型相配合设置。

[0026] 其中,针刺阵中的针刺呈斜向下倾斜设置,针刺阵与后跟贴本体的倾斜角度为0-90°。后跟贴本体的厚度为1-6mm,低针刺阵中针刺的长度为1.5mm,高针刺阵中针刺的长度为3.5mm。针刺阵中的针刺呈圆柱体设置,针刺中上部设有切面5,针刺的末端设有吸盘6。后跟贴本体的下端部构型呈凸弧形、凹弧形和凸弧形设置。高针刺阵4中的针刺上侧壁设有凹槽7。卡位面上设有斜撑8。黏胶固定面1为粘性胶水层、3M双面胶层或魔术贴层。黏胶固定面1上设有离型纸层。后跟贴本体为柔软材质制成,柔软材质包括硅胶、橡胶、软塑料。

[0027] 具体使用时,将黏胶固定面1贴于脚后跟磨脚或者不跟脚的适配位置,穿鞋的时候可直接顺势将针刺部分压下去,当脱鞋时,针刺阵中的针刺对鞋面施以反作用力,穿脱方便。本方案型防止磨脚跟和掉跟的后跟贴,穿着时针刺与鞋面摩擦力大,当掉跟现象可能发生时,针刺受到脱鞋力,并结合材料本身材质的韧性形成反作用力,这样真正有效避免了掉跟与不跟脚现象的发生。

[0028] 以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

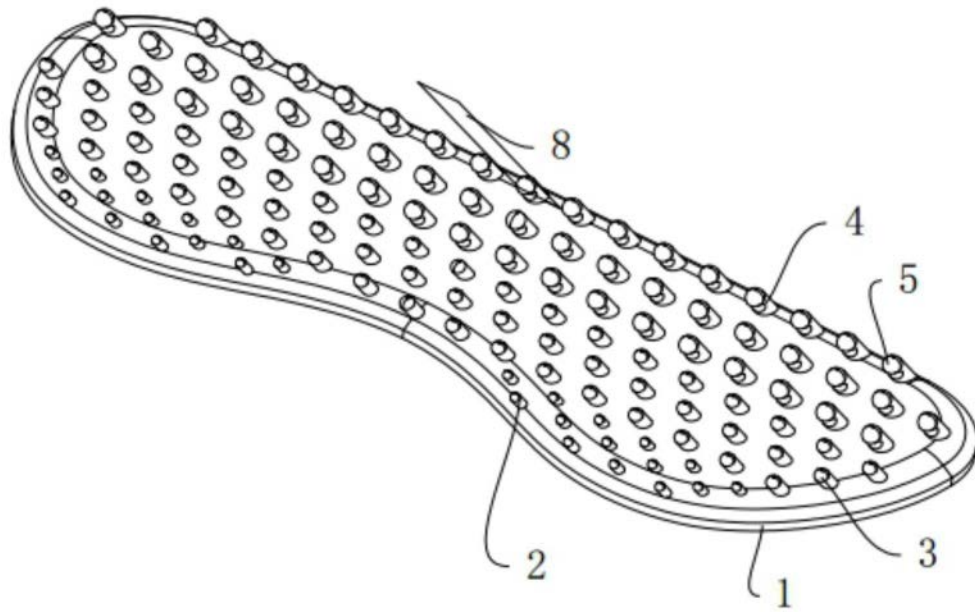


图1

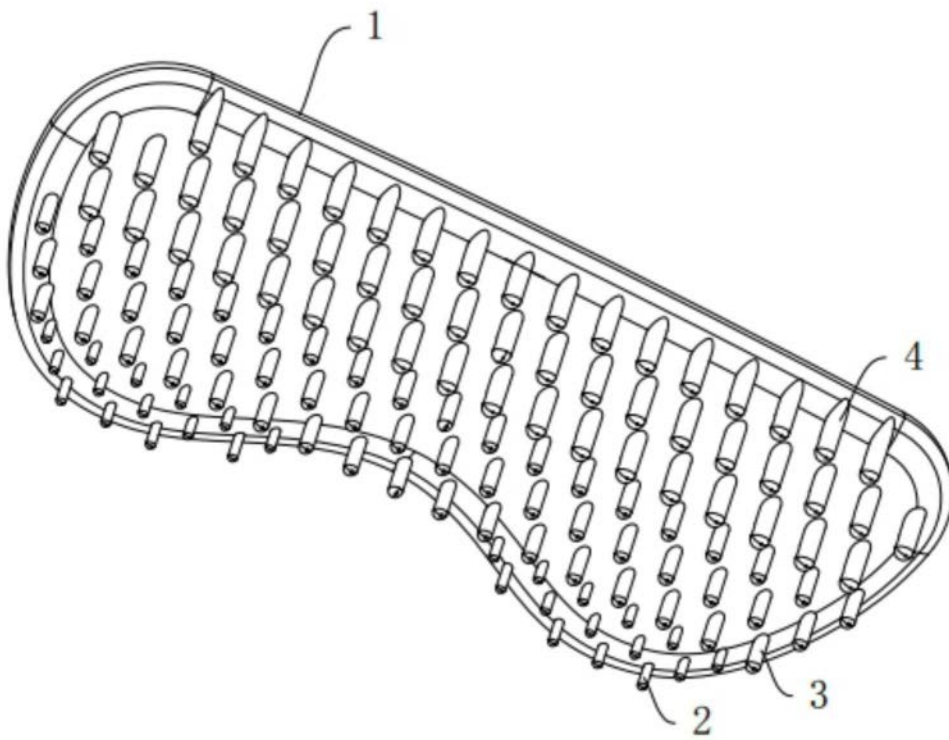


图2

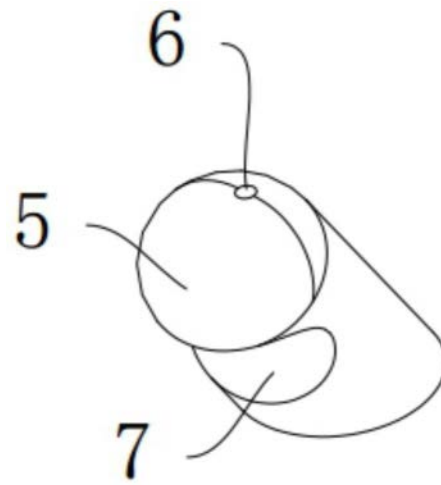


图3

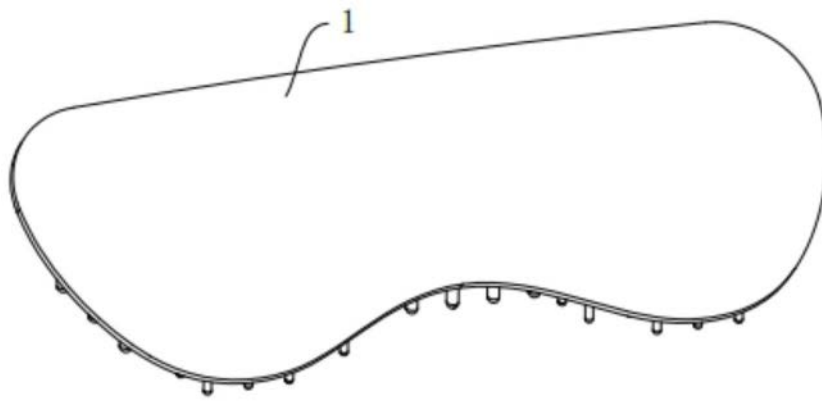


图4